(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月25日(25.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/197679 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/52 (2006.01) *H01L 25/18* (2023.01)
H01L 21/301 (2006.01) *H01L 25/065* (2023.01)
H01L 25/07 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/009019

(22) 国際出願日： 2025年3月11日(11.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-043370 2024年3月19日(19.03.2024) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (**RESONAC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 (JP).

(72) 発明者: 鳥羽 正彦 (**TOBA Masahiko**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 株式会社レゾナック内 (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹，外 (**HASEGAWA Yoshiki** et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 丸の内ＭＹ ＰＬＡＺＡ（明治安田生命ビル） ９階 創英国際特許法律事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) **Title:** THERMOSETTING RESIN FILM FOR SEMICONDUCTORS, INTEGRATED DICING/DIE BONDING FILM AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称： 熱硬化性樹脂フィルム、ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム、及び半導体装置の製造方法



(57) **Abstract:** Disclosed is a thermosetting resin film containing a photobase generator that generates a base by light irradiation. The thermosetting resin film may be used for bonding a semiconductor chip to a substrate while another semiconductor chip is embedded. The thermosetting resin film may be used for bonding a semiconductor chip to another semiconductor chip while embedding a part or the entirety of a wire connected to the another semiconductor chip.

(57) 要約： 光照射によって塩基を発生する光塩基発生剤を含有する、熱硬化性樹脂フィルムが開示される。当該熱硬化性樹脂フィルムは、半導体チップを、他の半導体チップを埋め込みながら基板に接着するために用いられるものであってよい。当該熱硬化性樹脂フィルムは、半導体チップを、他の半導体チップに接続されたワイヤの一部又は全体を埋め込みながら他の半導体チップに接着するために用いられるものであってよい。

WO 2025/197679 A1

［続葉有］

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）